

<<微系统封装原理与技术>>

图书基本信息

书名：<<微系统封装原理与技术>>

13位ISBN编号：9787121030314

10位ISBN编号：7121030314

出版时间：2006-9

出版时间：电子工业出版社

作者：邱碧秀

页数：228

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微系统封装原理与技术>>

内容概要

封装是一个跨领域的技术。

《微系统封装原理与技术》全面系统地介绍了封装技术，旨在使读者能对此技术全面掌握。

《微系统封装原理与技术》分为原理介绍、分析测试及应用三部分。

在原理介绍部分，重点介绍了电性设计、热管理、材料的选择和制程设计。

在分析、测试方面，介绍了产品的各种失效分析、可靠度设计及测试方法。

在应用方面，涵盖了不同产品（包括IC、光电、微机电等）封装技术，介绍了前瞻性的封装及封装技术的发展趋势。

《微系统封装原理与技术》可以作为大专理工院校封装方面课程教科书，或自我进修及实务上的参考用书。

<<微系统封装原理与技术>>

作者简介

邱碧秀，现任：中国台湾交通大学电子工程系所教授，为IEEE资深会员。

经历：曾任中国台湾交通大学创封装研究中心主任，曾于封装相关领域发表国际期刊论文一百余篇；中文著作有《电子陶瓷》徐氏基金会（1988年），英文著作有Thermal Stress and Strian in Microelectronic Packaging（editor:J.H.Lau,Von Nostrand Reinhold,1993）。

研究领域：高速资料传输之系统封装术。

<<微系统封装原理与技术>>

书籍目录

第1章 总论1.1 封装的定义及重要性1.2 封装的种类1.3 设计及制程的重要议题1.4 技术发展的趋势参考文献习题第一篇 微系统封装的基本的理和技术介绍第2章 电性设计概论2.1 基本的电性参数2.2 高频设计的考虑2.3 噪声和串音2.4 设计的程序参考文献习题第3章 热管理及应用、应变3.1 基本热传学3.2 封装的散热设计及方式3.3 应力和应变参考文献习题第4章 材料选择和制程设计4.1 基板材料及制程4.2 电介质4.3 封装材料4.4 导体及接合材料4.5 接合制程参考文献习题第二篇 微系统封装的分析及测试第5章 失效分析及可靠性设计5.1 失效机制及可靠性设计5.2 失效分析5.3 分析仪器及技术参考文献习题第6章 测试6.1 前言6.2 可靠性测试6.3 可靠性计算6.4 功能性测试参考文献习题第三篇 微系统封装的应用附录A 主要术语中英文对照

<<微系统封装原理与技术>>

编辑推荐

封装是一个跨领域的技术。

本书全面系统地介绍了封装技术，旨在使读者能对此技术全面掌握。

全书分为原理介绍、分析测试及应用三部分。

在原理介绍部分，重点介绍了电性设计、热管理、材料的选择和制程设计。

在分析、测试方面，介绍了产品的各种失效分析、可靠度设计及测试方法。

在应用方面，涵盖了不同产品（包括IC、光电、微机电等）封装技术，介绍了前瞻性的封装及封装技术的发展趋势。

本书可以作为大专理工院校封装方面课程教科书，或自我进修及实务上的参考用书。

<<微系统封装原理与技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>